

## **Stručný postup zpracování fotorezistu**

### **KOLON ACCUIMAGE řady KP 2100**

**Skladování:** 5-25 °C, 30-80% relativní vlhkosti vzduchu

**Odstavný čas:** válce fotorezistu by měly mít před laminací teplotu 20-25°C

**Laminace:** 100-120°C, 0,5 – 1,5 m/min, tlak 1,5– 4 bary, výstupní teplota na desce 45-65°C (optimum 48°C pro FR4 > 1,5 mm, 60°C FR4 < 1 mm)

**Odstavný čas:** min. 20 min (ochladnutí), max 72hod ve tmě anebo na certifikovaném žlutém světle, max 21°C

**Osvit:** čistá měď na 10 stupni 21stupňového klínu (energie 80 mJ/cm<sup>2</sup>)

**Odstavný čas:** max 2 měsíce, max. 18°C

**Vyvolání:** min. 28 s, 0,9-1,3 % Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> nebo K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, optimální koncentrace 1% (váhových), vyvolatelnost 0,04-0,15 m<sup>2</sup>/l  
teplota 28-32°C, bod zvratu 55-75% délky vyvolávací komory, oplach 1,5-3 bary  
min. 30 s při 15-30°C, pH 10,3 -11,3

**Leptání:** alkalické (do pH 9,4 v oplachovém modulu) i kyselé

**Stripování:** NaOH nebo KOH, koncentrace 2 – 4% (váhová), organické stripéry (RS 111 nebo K.I.V. ST 810, ST 811), koncentrace 5 – 30%, teplota 45 – 55 °C, bod zvratu 40 – 60% délky stripovací komory, oplach 1 – 3 bar min. 20 s

Dostupné šířky: 220- 310 mm (balení 2 role po 152 b.m. nebo 1 role 302 b.m.)  
Tloušťka rezistu: 38 µm (48 µm pro tenting)

Vyrábí: KOLON industries Inc. , Kyunggi-Do, Jižní Korea

revize listopad 2005